

作者：钱铮 来源：新华网 发布时间：2008-6-20 15:33:23

小字号

中字号

大字号

东芝新技术有望大幅提高芯片集成度

如何在一块芯片上集成更多的晶体管，是电子公司面临的一个重大课题。日本东芝公司日前宣布，它开发出一种新的布线流程技术，可以大幅提高芯片上的晶体管集成度。

东芝公司发布的新闻公报说，这种新技术的核心是，设计人员在计算机软件的帮助下，从设计阶段就能预测不同的布局对芯片上晶体管性能的影响，进而帮助设计者合理安排芯片上晶体管的位置和间隔，结果使单位面积内能放置更多的晶体管。

有专家认为，芯片上晶体管的集成度正在接近极限，英特尔公司今年初推出的一款四核安腾处理器采用65纳米工艺，已经集成了20.5亿个晶体管。东芝公司的新技术，可能将把人们原先认为的晶体管集成度极限再次提高。

发E-mail给:



[打印](#) | [评论](#) | [论坛](#) | [博客](#)

读后感言:

发表评论

相关新闻

- 美研发超级节能微型芯片 耗电量仅为普通芯片十分...
- 巴西为树木安装芯片 以遏制树木被非法砍伐
- 科学时报：生物芯片指导肿瘤个性化治疗
- 第一届中国生物芯片应用大会4月在京举办
- 日本开发出可检测20种病原体的DNA芯片
- 中国北斗导航核心芯片诞生 有望打破GPS垄断
- 韩国研制出新型医用生物芯片
- 我国遗传性耳聋基因芯片检测技术已获实际应用

一周新闻排行

- 科学家首次拍到女性排卵过程 展现人类生命起点
- 一所高校不同排名 大学排行榜让人“看不懂”
- 科学时报：震区，设防之思
- 76份中国期刊07年影响因子数据出炉
- 中国成功研制形似“UFO”的实用飞行器
- 科学时报：大学毕业生就业不应冲击教学
- 第四届高等学校教学名师奖候选人公示
- 夫妻档“评院士”敛财 50多位院士被利用充当诈...